

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成25年2月28日(2013.2.28)

【公開番号】特開2011-219674(P2011-219674A)

【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2011-044

【出願番号】特願2010-92205(P2010-92205)

【国際特許分類】

C 08 G	59/68	(2006.01)
C 08 J	5/24	(2006.01)
H 05 K	1/03	(2006.01)
B 32 B	15/08	(2006.01)
C 08 L	63/00	(2006.01)

【F I】

C 08 G	59/68	
C 08 J	5/24	C F C
H 05 K	1/03	6 1 0 T
H 05 K	1/03	6 1 0 L
H 05 K	1/03	6 1 0 K
B 32 B	15/08	U
B 32 B	15/08	J
C 08 L	63/00	C

【手続補正書】

【提出日】平成25年1月15日(2013.1.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0115

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0115】

(実施例3)

実施例1で用いた0.15質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートを、0.17質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラ(p-エチルフェニル)ボレートに替えて用いた以外は、実施例1と同様にして樹脂ワニスを調製し、プリプレグ、積層板、樹脂シート、プリント配線板、及び半導体装置を得た。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0116

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0116】

(実施例4)

実施例1で用いた0.15質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートを、0.18質量部のテトラフェニルホスホニウムテトラ(p-エトキシフェニル)ボレートに替えて用いた以外は、実施例1と同様にして樹脂ワニスを調製し、プリプレグ、積層板、樹脂シート、プリント配線板、及び半導体装置を得た。